

# 沈阳富创精密设备股份有限公司

## 关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心，于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年（以下简称“报告期”），公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将报告期内的主要工作成果报告如下：

### 一、 专注公司主营业务，提升核心竞争力

根据 SEMI 报告，全球半导体制造行业持续强劲增长，预计 2024 年底至 2028 年，全球产能将以 7% 的复合年增长率扩张。同期，先进工艺设备资本支出预计从 2024 年的 260 亿美元激增至 2028 年的 500 亿美元以上，年复合增长率高达 18%。SEMI《年中总半导体设备预测报告》进一步指出，2025 年全球半导体设备销售额预计达 1,255 亿美元（同比增长 7.4%），2026 年有望攀升至 1,381 亿美元，实现连续三年增长。

在 2025 年上半年，公司持续深化“大客户战略”核心方针，依托平台化与国际化的协同布局，系统提升对全球半导体设备龙头企业的综合服务能力。通过构建覆盖技术研发、生产制造与客户服务的平台化体系，致力于提升产品品质一致性、降低客户供应链风险，为客户提供从机械及机电零组件到气体传输系统的一站式解决方案。全球产能网络的加速建设进一步夯实了属地化服务能力，通过可靠交付能力与客户知识产权的严格保护，实现属地化服务的快速响应。报告期内，核心客户合作黏性持续增强，公司前五大客户营收占比合计达 75% 以上。

在业务拓展方面，2025 年上半年为保障产业链安全，公司联合战略投资人共同收购国际品牌 Compart 股权，通过本次收购，公司打通产业链关键环节，提升研发效率，实现关键产品的自主可控，增强了公司在气体传输领域的垂直整合能力和全球竞争力。报告期内，公司气体传输系统业务发展符合预期，订单维度

实现同比大幅增长，增长态势验证公司平台化战略的协同价值。公司将持续深化与 Compart 的业务技术协同，加速国产化进程和全球市场份额扩张。

同时，公司通过深化属地化布局和拓展业务协同，持续升级客户服务质量。国内来看，北京工厂定位为国内头部设备公司的重点配套基地，预计 2025 年投产后将显著提升公司在华北地区的响应能力与服务效率，支持国内半导体设备产业链的稳健发展。报告期内，公司在京建设的首条匀气盘专线已顺利投产，旨在为客户提供更精准、高效的定制化服务与快速响应，并加强关键零部件的知识产权保护机制。海外方面，新加坡工厂已于 2024 年通过核心客户认证并实现交付，未来将依托属地化服务优势及有利的关税条件，进一步提升公司在国际市场的竞争力。公司采取多工厂物理隔离运营模式，严格执行客户 IP 保护措施，持续巩固与大客户的战略合作关系。

## 二、 加快发展新质生产力，创新配置生产要素

公司始终专注于半导体设备精密零部件的研发制造，通过聚焦大客户战略，加速全球化布局，加强产品与技术的研发、构建从需求洞察到快速交付的全链条响应能力，为行业客户提供高效、精准的解决方案，进一步增强公司在国内外市场的竞争力，业务规模持续增长，进一步巩固了公司在半导体设备零部件市场的领先地位，为未来业务的持续增长奠定了坚实基础。

作为长期服务国内外领先客户的半导体设备精密零部件企业，公司持续推进技术升级与产品迭代，强化研发能力并深化市场拓展。其中在匀气盘领域，螺纹斜孔匀气盘已实现规模化量产，成功应用于 PEALD 机台；加热匀气盘于报告期内完成研发并加速推进客户验证，可适配 CVD、ETCH 等核心机台；交叉孔焊接匀气盘具有复杂结构并对焊接工艺具有超高要求，公司成功在报告期内实现量产突破，主要配套 ALD、PVD 设备。除此外，公司金属加热盘研发成功突破海外技术壁垒，实现多型号量产，并成为国内主流客户主要供应商，彰显公司在高端零部件领域持续强化的技术自主能力与产品竞争力。

技术研发方面，公司重点深耕精密机械制造技术、表面处理特种工艺、焊接工艺及气体传输系统集成技术等几大关键领域。通过持续的研发投入，在上述领域形成了差异化技术壁垒。

随着半导体设备向更高集成度、更严苛工艺环境演进，公司技术组合在复杂结构件加工与表面完整性控制方面的优势将持续释放，为国产装备突破更先进逻辑芯片及半导体制造瓶颈提供关键工艺支撑。

报告期内，公司通过“超高精密加工技术”实现  $\mu\text{m}$  级形位公差控制，成功交付超临界清洗设备核心零部件；通过“超高光洁度制造技术”突破深径比 50 倍以上的超深孔加工瓶颈，表面粗糙度稳定维持机加高光标准，奠定超细深流道设计基础。

除此外，公司在表面处理特种工艺领域构建了差异化技术优势，喷涂技术领域，自主开发的“致密 Y0 涂层”在 2024 年完成国内头部客户首件认证后，2025 年快速导入量产阶段；纳米薄膜技术领域，公司开发的“N 系列膜层、O 系列膜层”全面量产交付，其中“O 系列膜层”凭借高洁净度控制及耐腐蚀性能，成功通过国内头部客户认证，并稳定应用于核心部件。基于其优异的性能表现，公司已被推荐至其他国内半导体设备头部企业，目前相关产品认证进展顺利，随着国产替代进程加速及下游先进制程需求扩张，“O 系列膜层”的应用场景将进一步增加，具有广阔市场空间。“N 系列膜层”在报告期内锁定国内头部客户年百万级订单，技术优势转化为持续商业增量。

随着先进制程对耐高温、粒子控制及金属污染抑制要求的指数级提升，公司表面处理技术的性能壁垒将进一步增厚，为国产半导体设备突破更先进逻辑芯片制造瓶颈提供底层工艺支撑。

未来，公司仍将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发创新力度，重点聚焦原有核心技术的升级迭代以及先进制程产品应用技术的开发，为半导体设备精密零部件的规模化生产提供关键工艺保障，有效支撑国内半导体设备厂商在先进制程的供应链安全。

### 三、 积极保障投资者权益，统筹规划业绩与回报的动态平衡

#### 1、 权益分派

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。2024 年年度，公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民

币 1.50 元（含税），合计派发现金红利 45,681,688.2 元（含税）。上述利润分配已在 2025 年 7 月 17 日派发完毕。

## 2、回购股份注销

2025 年 3 月 11 日公司披露《关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011），公司注销回购专用证券账户中的部分股份 1,817,224 股，占注销前股份总数的 0.5900%，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。注销完成后，公司总股本由 308,027,995 股变更为 306,210,771 股，注册资本由人民币 308,027,995 元变更为人民币 306,210,771 元。

未来，公司仍将结合业务现状以及未来发展规划，统筹规划公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》利润分配政策的前提下，维持并努力提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

## 四、 完善与投资者沟通机制，夯实资本市场发展基础

报告期内，公司积极接听投资者专线、回复“上证 E 互动”平台提问，在“上证路演中心”、“进门财经”平台举办业绩说明会。

除业绩说明会外，公司通过线上及线下方式接待投资者交流，持续与资本市场沟通公司经营管理状况、产品技术、产能建设等相关信息，充分保护投资者合法权益。2025 年 6 月，公司参与同花顺联合东海证券组织的“我是股东”走进上市公司活动，活动汇聚了来自全国各地的产业专家，行业专家、机构投资者，此次活动一方面向投资者展示了公司良好形象，一方面也为公司、机构、产研之间架起沟通桥梁，搭建起高效能、高质量的交流平台。

2025 年，公司将继续关注股东诉求、重视资本市场，严格遵循法律法规及监管要求，依照公司《投资者关系管理办法》积极展开投资者交流活动并及时履行信息披露义务。

## 五、 持续完善公司治理，提升规范运作水平

在三会运作方面，公司在报告期内共召开股东大会 2 次，董事会 3 次，监事会 2 次，发挥了董事会、各专门委员会、监事会、独立董事的各项职能。

未来，公司仍将践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体

股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展。

## **六、 进一步改进措施**

未来，公司将持续评估行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，并将继续专注主业，通过良好的盈利能力、经营质量和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年8月29日